



KMT-8211 LED 环氧封装胶饼

产品用途

KMT-8211 环氧胶饼用于 LED 的热注塑型封装。

产品特性

1. 优异的流动特性可满足多种封装条件
2. 较高的玻璃化转变温度使得材料在高温环境下拥有较好的耐热稳定特性
3. 用于 LED 封装时拥有良好的适用性和可靠性

封装时注意事项

KMT-8211 不同于传统的 EMC 封装材料，在使用前一定要严格遵守如下要求。

回温

KMT-8211 从冷库中取出后，材料必须在温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度为 $40\pm 15\%$ 的环境下闭口放置不少于 24 小时至工作环境后方可打开使用，避免环境温差导致材料吸水。

预热

KMT-8211 材料在投入注塑压机前需要使用红外加热机对胶饼进行预热，严格控制加热温度和时间，使胶饼内外温度相同。

封装条件

KMT-8211 需要配合外脱模剂（有机硅或氟化合物）一起使用，以获得优异的脱模性能。不同的封装模具设计、芯片结构可能需要使用不同的封装条件。一般推荐 KMT-8211 在使用时采用如下封装条件。

项目	单位	参数范围
预热温度	$^{\circ}\text{C}$	75-95
固化温度	$^{\circ}\text{C}$	150-170



版本: K01141223

KMT-8211 LED 环氧封装胶饼

固化压力	MPa	3-8
转进时间@150°C	sec	40-60
固化时间@150°C	sec	150-240
后固化时间@150°C	hours	3-4

使用要求

在使用KMT-8211之前, 模具必须经过彻底清洗和喷脱模剂。当进行封装时, 建议前三模固化5-10分钟, 以补偿清模时造成的模具和注塑头的温度降低。固化时间的增加也是为了确保浇口和排气口完整脱模, 以免污染模具, 影响后续封装生产。

产品性能

KMT-8211在实验室150°C成型时间为4分钟、150°C后固化时间为4小时的条件下列得产品性能如下:

产品性能	测试条件	单位	参数	备注
硬 度	Shore D	-	Min 80	@25°C
凝胶化时间		sec.	35-50	@150°C
螺旋流动长度		cm	100-160	@150°C
固化收缩率	JIS K 6911	%	Max 1.5	
玻璃化转变温度		°C	Min 120	@TMA
热膨胀系数 α_1		$10^{-5}K^{-1}$	6-10	
热膨胀系数 α_2		$10^{-5}K^{-1}$	15-19	
弯曲强度		MPa	Min 110	
弯曲模量		GPa	2.6-3.5	
比 重		-	1.24-1.30	
400nm透光率	Spectrophotometer	%	Min 85	1.0mm ^t

以上数据在实验室测得, 不能保证数据广泛有效性



版本: K01141223

KMT-8211 *LED 环氧封装胶饼*

包装储存

KMT-8211 可以根据客户需求, 采用特定尺寸和重量的饼料提供方式。饼料包装, 10Kg/纸箱。

KMT-8211 粉料或饼料必须储存在冷库或冰柜中, -10°C 以下密封保存六个月。

声明: 北京康美特科技有限公司拥有此产品说明书的最终解释权, 未经北京康美特科技有限公司许可, 任何公司和个人不得引用和泄露说明书内容。